

2022.3.1 新闻发布

## 本公司接受了海外大型半导体封装基板厂商 购买“焊锡植球设备”的大型订单

艾美柯技术株式会社（AIMECHATEC, Ltd.，总部：日本茨城县龙崎市向阳台，社长：阿部猪佐雄）接受了海外大型半导体封装基板厂商购买包括检查·修补设备的焊锡植球设备整套生产线系统的大型订单，特此发布。

现在5G通讯、大数据(Big Data)、物联网(IoT)、人工智能(AI)等的普及在逐渐加速，所利用的数据中心、移动终端以及车载终端等的半导体封装的需求量也在扩大，同时也需要应对安定的品质和进一步提高良品率的需求。

本公司将其核心技术如高精度对位技术和培养半世纪以上的印刷技术以及实际经验，融入到新型G系列产品中向客户提案，结果受到高度评价，从而达成本次交易。

FCBGA、MCU/MPU、2.5/3D、扇出(fanout)等的先进半导体封装对高品质·高良品率的需求更为显著，所以能实现更高良品率的本设备已成为最佳选择。本公司期待它将会为半导体相关事业的扩大做出更多的贡献。

本公司愿意通过制程工艺上的不断创新，为了创造更舒适方便，更丰富多彩的生活方式，为社会做出更多的贡献而努力。

**咨询：**艾美柯技术株式会社

营业部 TEL：0297-62-9119

[https://www.ai-mech.com/wp\\_zh/](https://www.ai-mech.com/wp_zh/)